

2014年1月吉日

第15回半導体パッケージング技術展出展のご案内

テラプローブは、2014年1月15日(水)～17日(金)に、東京ビッグサイトで開催される第15回半導体パッケージング技術展に出展いたします。

当社は、SAMURAI CSP ProviderとしてWLP(Wafer Level Package)、ウエハテスト、ファイナルテスト、テープ&リールを一貫して提供するターンキーサービスを展開しておりますが、今回の展示では、DRAMをWLP化した実動モデルをご紹介します。また、製品・技術セミナーにおいては、WLP製品の実装状況の説明と今後の市場予想、将来予想される問題点及びその解決方法のご提案を予定しております。

是非ご来場賜りますようお願い申し上げます。

■半導体パッケージング技術展開催概要

期間 2014年1月15日(水)～17日(金)
場所 東京ビッグサイト 東棟

■当社出展概要

ブース 東5ホール 東40-47

■当社発表セミナー概要

製品・技術セミナー

<http://jan2014.tems-system.com/exhiSearch/INW/jp/Workshop>

開催日 2014年1月17日(金)
場所 東4ホール 東C会場
時間 12:20-13:20
内容 WLP(Wafer Level Package)の製品実装技術
講演者 アドバンスドパッケージ開発部門 脇坂伸治

● 本件に関するお問い合わせ先

sales@teraprobe.com

電話: 045-476-1002